

НОВИЙ МЕТОД ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З ВІДПРАЦЬОВАНОГО ТЕПЛА ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОЇ ПІНИ

Кавей Г.

(Центр дослідження матеріалів і енергій, n/я 14155-4777, Тегеран, 11369, IPAH)

Кавей Г.

• Термоелектричні модулі з об'ємними елементами призначені головним чином для відводу відпрацьованого тепла з гарячого середовища. Тепло, зокрема відпрацьоване тепло, відводиться від поверхні твердих тіл і газоподібних середовищ. Термоелектричні модулі у вигляді термопар (р и п типів) звичайно створюються з об'ємних термоелектричних елементів, розташованих між двома плоскими керамічними пластинами. Нові розроблені відкриті й закриті пористі пінисті структури – це перспективна конструкція термоелектричних модулів для перетворення відпрацьованого тепла, що відводиться від гарячої об'ємної поверхні або джерел газоподібних середовиш. Можна передбачити, що завдяки великій пористості й площі поверхні піниста структура порівняно з її об'ємним аналогом виявиться ефективнішим вирішенням для відводу тепла. Термоелектричні піни були розроблені, виготовлені й охарактеризовані. Пористі піни як репліки (Bi_{0.25}Sb_{0.75})₂Te₃ і порошку повареної солі синтезовані за різних температур у системі гарячого штампування. Вихідні речовини отримані механічним легуванням, а нові структури охарактеризовані за допомогою диференціального термічного аналізу, рентгенівської дифрактометрії, скануючої електронної мікроскопії й класифікації розмірів часток порошків. Коефіцієнт Зеєбека, електропровідність, відносна щільність і теплопровідність пін були виміряні або оцінені емпірично.

Вступ

Виробництво термоелектричних (ТЕ) модулів із традиційних матеріалів добре відоме й поширене в промисловості [1]. Однак виготовлення модулів на основі пінистих матеріалів з'явилося нещодавно, і повідомлення про їхніх робочі характеристики малочисельні. Піниста природа ТЕ елементів і технічні умови обробки, що включають температуру навколишнього середовища, ускладнюють процес їх виготовлення й роблять його відмінним від виготовлення Традиційних ТЕ модулів. У пропонованій праці ми описуємо: (І) процес виготовлення ТЕ модулів на основі телуриду вісмуту й пінистих матеріалів ($Bi_{0.25}Sb_{0.75}$)₂ Te_3 і (ІІ) сіль як елемент репліцированої сировини. Пористі пінисті структури дають можливість розробляти ефективні ТЕ модулі для джерел відпрацьованого тепла, включаючи газоподібні середовища. Більша площа фізичного контакту ТЕ пінистих елементів з гарячими середовищами робить їх ефективними генераторами електроенергії [2].

Проте пористі ТЕ матеріали – добрі кандидати для утримання фононів (коливань гратки) з метою зменшення теплопровідності, якщо пори досить малі. Робочі характеристики модулів і можливі фактори, що обмежують їхню теоретичну продуктивність, розглянуті в праці [3]. Вводиться параметр, що описує якісні характеристики модулів, який відомий як виробничий коефіцієнт, що являє собою сукупний ефект різних факторів, що беруть участь у процесі виготовлення; модулі оцінюються й порівнюються з іншими модулями, про які повідомлялося раніше.

Відмічалося, що незвичайний характер зміни як електронних властивостей, так і властивостей теплопередачі термодинамічно стійких систем, істотно впливає на еволюцію

конденсованих середовищ [4-5]. Справді, температурна залежність електропровідності [6], коефіцієнта Зеєбека [7] і теплопровідності [8-9] переконливо вказує на те, що ТЕ сплави мають бути розташовані на границі між металами й напівпровідниками [10]. Пошук нових високоякісних ТЕ матеріалів являє собою складне завдання [11]. Ефективність ТЕ пристроїв залежить від коефіцієнтів переносу складових матеріалів і може бути належним чином виражена через добротність, обумовлену безрозмірним виразом

$$\theta \equiv ZT = \frac{T\sigma\alpha^2}{\kappa_e + \kappa_{ph}},\tag{1}$$

де T – температура, σ – електропровідність, α – коефіцієнт Зеєбека, а κ_e і κ_{ph} – відповідно електронна й граткова фононна теплопровідність. У зв'язку із цим виникає цікаве питання: чи може нерівномірність властивостей переносу бути належним чином збалансована в рівнянні (1), щоб одержати перспективну стехіометрію для ТЕ застосувань. Така можливість останнім часом обговорюється в літературі з погляду низки експериментальних результатів [12].

Експериментальна частина

Як вихідні матеріали були отримані Bi, Te i Sb з високим ступенем чистоти (99.999 %) [13]. Для оцінки ступеня чистоти й хімічного елементарного аналізу застосовувався індуктивно зв'язаний плазменно-мас-атомно-емісійний спектрофотометр (ICP-AES, модель ARL 3410 +). Атомна абсорбційна спектроскопія (AAC) показала наявність у зразках часточок небажаних елементів. Аналізи було здійснено з декількома елементами (Cu, Fe, Ni, Pb i S) із застосуванням графітової печі типу 932 плюс, GBC.

Порошки були зважені в стехіометричному співвідношенні $(Bi_{0.25}Sb_{0.75})_2Te_3$, а потім завантажені в чашу з нержавіючої сталі (125 мол) за вагового співвідношення куль і порошку 10:1. П'ять куль із високохромистої нержавіючої сталі діаметром 20 мм знаходилися в атмосфері аргону під тиском 3 атм. Експерименти з кульовим здрібнюванням здійснювалися в планетарному шаровому млині зі швидкістю обертання чаші й основного диска 275 і 525 обертів у хвилину відповідно упродовж 5, 10 і 15 годин. Зразки вилучалися з перервами в процесі здрібнювання в шаровому млині різної тривалості для проведення аналізу. Було отримано порошок сплаву зі співвідношенням розмірів часток [64 % із коміркою 80 меш (200 мкм²)/36 % і із коміркою 60 меш (250 мкм²)].

Поварена сіль (хлорид натрію NaCl з розміром часток порошку 150 - 212 мкм і 99.0 % чистоти) була обрана як елемент репліцированої сировини. Хлорид натрію був подрібнений у планетарному шаровому млині із чашею з нержавіючої сталі упродовж 20 годин. Здрібнювання в шаровому млині виконувалося зі швидкістю обертання чаші 270 обертів за хвилину. Діаметр куль у шаровому млині становив 17 мм, а вагове співвідношення куль і порошку становило 10:1. Розміри кристалітів можна оцінити за допомогою чотирьох різних методів [14 – 15]. Розміри часток отриманого порошку були визначені за допомогою системи "Fritsch Gmbh analysette 22". Розміри більше 30% популяції часток для NaCl становили 4 – 8 мкм.

Щільності *NaCl* і ($Bi_{0.25}Sb_{0.75}$)₂ Te_3 відповідають 2.17 і 6.80 г·см⁻³ [16]. Вони були призначені для розрахунків відносної ваги ТЕ матеріалу/*NaCl* і досягнення певної пористості. Термоелектричну піну було оброблено змішаним подрібненим механічно легованим порошком ($Bi_{0.25}Sb_{0.75}$)₂ Te_3 і порошками *NaCl*. Вагове співвідношення 2.04 / 1.52 ТЕ матеріалу / *NaCl* розраховано для одержання ТЕ піни відносною пористістю 70 % (див. таблицю 1). Відносна пористість змінюється не тільки шляхом регулювання відносної ваги ТЕ матеріалу / *NaCl*, але також за допомогою варіювання розміру елементарної частки матеріалів [2].

Кавей Г.

<u>Таблиця 1</u>

	Експеримент						Теорія			
Відносна пористість матеріалу	$(Bi_{0,25}Sb_{0,75})_2Te_3$	NaCl	Відносна пористість	Відносна щільність	Маса піни	Залишок NaCl	Теоретична відносна щільність	$(Bi_{0,25}Sb_{0,75})_2Te_3$	NaCl	Розмір
63%	2.516	0.0684	62%	38%	2.5844	5%	37%	2.516	1.3671	1 см ³
65%	2.38	0.1128	64%	367%	2.4928	8%	35%	2.38	1.41	1 см ³
70%	2.04	0.076	69%	31%	2.116	5%	30%	2.04	1.52	1 см ³
75%	1.7	0.0813	74%	26%	1.7814	5%	25%	1.7	1.63	1 см ³

Теоретичні й практичні аспекти досягнення пористості в певній експериментальній конфігурації за T = 300 °C.

Змішаний механічно легований порошок і сіль об'ємом 1 см³ у різних співвідношеннях ТЕ матеріалу / NaCl (див. таблицю 1) зазнали пресування в гарячому вигляді під тиском 500 МПа у сталевій формі. Було отримано пінисті зразки із закритими комірками розміром $5 \times 10 \times 20$ мм³. Квазістатичний одноосьовий стиск впливав на поперечний переріз 5×20 мм. Таким чином, напрямок сили (поздовжній напрямок) застосовувався по довжині 10 мм у всіх зразках у межах контрольованого переміщення рамки гідравлічного навантаження. Усі випробування здійснювалися в поздовжньому й поперечному напрямках. Поздовжній і поперечний напрямки – це всі напрямки, що пролягають паралельно й перпендикулярно напрямку пресування зразка відповідно. Гаряче пресування здійснювалось за температур 300, 400 і 500 °С и тиску 500 МПа в атмосфері аргону впродовж однієї хвилини. Стиск повторювався кілька разів за обох температур для досягнення високого ступеня ущільнення. Така повільна швидкість спікання дає можливість уникнути внутрішніх напружень і мікротріщин, що призводить до утворення ідеальних компактних кристалітів (від поверхні до серцевини). Щільність зразків вимірялася на кожній стадії гарячого пресування. Ця процедура зупиняє процес розкладання піни, видаляючи з неї сіль. Властивості піни багато в чому залежать від тривалості пресування [2]. Для справжнього дослідження система пресування не може перебувати під навантаженням упродовж тривалого часу. Проте несправності системи пресування не дають нам контролювати тимчасові ефекти.

Гарячепресований зразок кип'ятили у воді упродовж 2 годин з метою видалення *NaCl* із сировинної піни. Це дозволяє одержати чисту ТЕ піну.

Заздалегідь встановлена відносна щільність піни вимірювана методом Архімеда за допомогою системи балансу (Mettler-Toledo Модель AG285). Відносна щільність піни з урахуванням її об'ємних аналогів становила близько 30 %. Розумне відхилення від реальної величини відносної щільності показує, що приблизно 5 – 7 % *NaCl* залишилося в піні. Порошок $(Bi_{0.25}Sb_{0.75})_2Te_3$ хімічно стійкий до стиску й будь-якого нагрівання в наявності *NaCl* для зв'язування часток, що дозволяє нам працювати із системою гарячого пресування. Тиск і вміст у прес-формі

регулюються таким чином, що роблять можливим одержувати щільно впаковані зразки.

Ідентифікація фаз спечених компактів проводилася за допомогою рентгенівської дифрактометрії (РД) [у системі Philips X'pert, (30 кВ і 25 мА) дифрактометра з *СиКа* випромінюванням ($\lambda = 1.5405$ Å) з розміром кроку 0.02 і часом на крок 1 с]. Морфологія спеченого матеріалу в поздовжньому й поперечному перерізах вивчалася за допомогою скануючого електронного мікроскопа (СЕМ) (Cambridege-30S скануючого електронного мікроскопа (СЕМ), що працює за 25 кВ) для виявлення фаз, що утворюються, і мікрофотографії поверхонь.

Ефективність пінистих структур як ТЕ галузі була вивчена за різних температур спікання в процесі простого опису характеристик піни (рис. 1.). Функція була оптимальною для зразка за 500 °C під тиском 500 МПа. У конфігурації кола з полум'ям газового пальника Бенсона як джерела тепла, термопарою й мілівольтметром як вимірювальних систем було встановлено, що піна має напругу розімкнутого кола 10 мВ за 300 °C і прикладений градієнт температур 200 °C.



Рис. 1. Проста система для опису характеристик піни. Функція була оптимальною для зразків за 500 °C під тиском 500 МПа. Конфігурація ланцюга з полум'ям газового пальника Бенсона в якості джерела тепла, термопарою й вольтметром в якості вимірювальних систем.

Вимірювання напруги Зеєбека здійснюється за нагрівання одного кінця й появі результуючої напруги між двома кінцями віток. Напруга Зеєбека виміряється безпосередньо на піні відповідно до [17]. Електропровідність досліджувалася методом, рекомендованим в [18]. Оскільки на поверхнях було багато порожнеч, електричні контакти для піни було виготовлено шляхом нанесення срібної фарби приблизно до 2 мм довжини на обох кінцях. Теплопровідність (κ) зразків вимірювана в поздовжньому напрямку за допомогою обладнання, розробленого в нашій лабораторії [19]. Нарешті, добротність ($Z = \alpha^2 \sigma / \kappa$) розраховувалася для температурних діапазонів спікання, як згадувалося вище.

Результати й обговорення

Для того щоб оцінити вплив процесу механічної сплавки на формування й поведінку порошку Bi_2Te_3 , а потім ($Bi_{0.25}Sb_{0.75}$)₂ Te_3 , отримані порошки Bi_2Te_3 через різні проміжки часу піддавалися диференціальному термічному аналізу зі швидкістю нагрівання 10 °C·хв⁻¹ на повітрі. У тільки що отриманому зразку ендотермічний пік за 270 °C відповідає плавленню вісмуту [20], а інший екзотермічний пік за 418 °C відповідає утворенню Bi_2Te_3 . Це підтверджується негативною ентальпією утвореного Bi_2Te_3 (– 119.7 кДж·моль⁻¹), що відповідає величині тепла, яке виділяється за реакції вісмуту й телуру [20]. Криві диференціального термічного аналізу (ДТА) тільки що отриманих (відразу після змішування) і механічно легованих порошків Bi_2Te_3 через різні проміжки часу (після 10 годин і 5 годин здрібнювання) представлені на рис. 2. У 10годинному процесі за виготовленням сполуки велося повне спостереження. На рис. 3 зображено морфологію механічно легованих порошків, які були отримані протягом 10-годинного здрібнювання в шаровому млині. Щільна мікроструктура зерен порошку, розміром часток яких у більше ніж 30 % випадків становлять від 20 до 40 мкм, очевидна. На рис. 4 показано морфологію поверхні ТЕ піни з відносною пористістю 70 % за 500 °C температури гарячого пресування. На зображенні можна відзначити щільну структуру, утворену на поверхні, а розмір пор становив порядку 2.5 мкм.



Рис. 2. Диференціальний термічний аналіз (ДТА) типового утворення сполуки Ві₂Те₃.



Рис. 3. Морфологія механічно легованого порошку, виготовленого упродовж 15 годин у шаровому млині.



Рис. 4. Морфологія поверхні ТЕ піни з відносною пористістю 70 % за температури гарячого пресування 500 °С. Розмір пор становить порядку 2.5 мкм.

На даному етапі зразки були досліджені методами рентгенівської дифрактометрії. На рис. 5 показано дифрактограму кристалізованої піни $(Bi_{0.25}Sb_{0.75})_2Te_3$, всі піки позначені на фазах $(Bi_{0.25}Sb_{0.75})_2Te_3$ і *NaCl* без наявності домішок. Для визначення пінистої структури на дифрактограмі слід зазначити, що основні піки для кристала *NaCl* перебувають при 2 θ = 27.5, 31.7, 42.5, 51.5 і 68.5, 2 θ гради [21], а для ТЕ матеріалу – при 2 θ = 17.5, 28, 38, 45 і 57, 2 θ гради. У таблиці 2 наведено різні параметри, які вимірялися в різних температурних режимах. Таблиця показує, що збільшення температури гарячого пресування призводить до збільшення щільності й електропровідності через розширення порожнеч і зниження коефіцієнта Зеєбека.

<u>Таблиця 2</u>

memnepumyp cupr toco npecyounin									
Параметри	<i>T</i> ₁ (300 °C)	<i>T</i> ₂ (400 °C)	<i>T</i> ₃ (500 °C)						
α (мкВ / К)	189	187	186						
σ (Ом·см) ⁻¹	95	106	120						
κ (Вт·см ⁻¹ К ⁻¹)	1.3	_	_						
ρ / ρ ₀ (%)	30	30.5	31						

Різні фізичні параметри, вимірювані для ТЕ пінистого модуля за різних температур гарячого пресування



Рис. 5. Дифрактограма кристалізованої піни (Bi_{0.25}Sb_{0.75})₂Te₃.

Перспектива

Як відзначено у праці [22], передбачається, що пори однорідні, а куби з довжиною кромки l розділяються шириною 2w. При цьому кожна комірка складається з кубічного простору, оточеного стінкою товщиною w. Для $l \approx 2w$ електричні й теплові потоки є лінійними. Проте у реальній піні пори будуть зовсім відрізнятися від пор у передбачуваній моделі, але вплив на властивості переносу зберігається.

Теплопровідність κ_p пор, що містять газ, звичайно набагато менша, ніж теплопровідність κ_s ТЕ матеріалу. У цьому випадку теплопровідність K_o (ефективна провідність пористого матеріалу кожної комірки) виражається в такий спосіб:

$$K_{C} = \frac{\kappa l}{\kappa / \kappa_{p} + 2w/l} + \frac{\kappa l [(1 + 2w/l)^{2} - 1]}{1 + 2w/l}.$$
(2)

Ефективна теплопровідність – це локальна об'ємно-усереднена теплопровідність, використовувана для рідко-наливних матриць з допущенням локальної теплової рівноваги між твердою й рідкою фазами. Ефективна теплопровідність не тільки є функцією пористості й теплопровідності кожної фази, але дуже чутлива до мікроструктури [23]. Оскільки теплопровідність газу в порах порівняно з теплопровідністю ТЕ матеріалу була незначною, теплопровідність кожної комірки (*K*_s – теплопровідність твердого матеріалу) буде виражена як [24]

$$K_{s} = \frac{\kappa l[(1+2w/l)^{2}-1]}{1+2w/l},$$
(3)

де відносна теплопровідність $K_{rel} = K_C / K_s$. Це аналогічно співвідношенню добротності Z_p пористого матеріалу й Z_o зразка максимальної щільності. Х.Дж. Голдсмід розрахував це співвідношення для порожнеч, заповнених повітрям, вуглекислим газом і криптоном. Він показав, що в цих трьох випадках добротність зменшується, так само як і коефіцієнт пористості p. Коефіцієнт пористості p визначається як співвідношення електропровідності матеріалу максимальної щільності й електропровідності пористого матеріалу. Оскільки електропровідність газів всередині пор є незначною,

$$p = \frac{(1+2w)^2}{(1+2w)^2 - l^2}.$$
(4)

Добротність знижується приблизно на 20 % за коефіцієнта пористості 10, якщо пори заповнені повітрям, і ті ж 20 % за аналогічного коефіцієнта пористості, який становить менше 10 %, якщо використовується газ криптон.

Висновки

Перспективи пінистих структур досить багатообіцяючі. За допомогою ТЕ піни можна проектувати унікальні й ефективні ТЕ модулі, зокрема для спеціальних джерел тепла. ТЕ піни також становлять інтерес для заміни об'ємних ТЕ елементів у традиційних конструкціях модулів. Розглянутий процес одержання піни з високоефективних термоелектричних матеріалів і концепція застосування пінистих структур для відводу відпрацьованого тепла з газоподібних середовищ. Більша площа поверхні й оптимальна пористість піни 70 % дають можливість забезпечити ефективний відвід тепла в порівнянні з об'ємними матеріалами. Термоелектричний матеріал ($Bi_{0.25}Sb_{0.75}$)₂ Te_3 був оброблений як репліка сольової піни й випробуваний як термоелектричний генератор. У простої конструкції термоелектричного модуля напруга розімкнутого кола 10 мВ була виміряна за 300 °C і прикладеного температурного градієнта 200 °C.

Література

- 1. B.I. Ismail, W.H. Ahmed, TE Power Generation Using Waste-Heat Energy as an Alternative Green Technology, Recent Patents on Electrical Engineering, 2, 27 39 (2009).
- 2. E.S. Reddy, J.G. Noudem, C. Goupil, <u>Open Porous Foam Oxide Thermoelectric Elements for Hot</u> <u>Gases and Liquid Environments</u>, Energy Conversion and Management 48(4), 1251 – 1254 (2007).
- 3. K. Vafai, Handbook of Porous Media (CRC Press Taylor & Francis Group, USA, 2005).
- 4. A.P. Tsai, A. Inoue, T. Masumoto, Stable Icosahedral *Al-Pd-Mn* and *Al-Pd-Re* Alloys, Mater. Trans. Jpn. Inst. Metal. 31, 98 103 (1990).
- C. Janot, Conductivity in Quasicrystals via Hierarchically Variable-Range Hopping, Phys. Rev. B 53, 181 – 191 (1996).
- 6. O. Rapp, in: Physical Properties of Quasicrystals, Springer Series in Solid-State Physics, Vol. 126, ed. by Z.M.Stadnik (Springer, Berlin, 1999).
- 7. F. Giraud, T. Grenet, C. Berger, P. Lindqvist, C. Gignoux, G. Fourcaudot, Resistivity, Hall Effect and Thermopower in AlPdMn and AlCuFe Quasicrystals, Czech. J. Phys. 46, 2709 16 (1999).
- 8. J.W. Sharp, C.B. Sales, D.G. Mandrus, B.C. Chakoumakos, Thermoelectric Properties of *Tl*₂*SnTe*₅ and *Tl*₂*GeTe*₅, Appl. Phys. Lett. 74 (25), 3794 96 (1999).
- 9. P.A. Kalugin, M.A. Chernikov, A. Bianchi, H.R. Ott, Structural Scattering of Phonons in Quasicrystals, Phys. Rev. B 53, 14145 51 (1996).

- R. Tamura, A. Waseda, K. Kimura, H. Ino, <u>Semiconductor-like Transport in Highly Ordered Al-Cu-Ru Quasicrystals</u>, Phys. Rev. B 50, 9640 43 (1994).
- 11. T.M. Tritt, Thermoelectric Materials: Holey and Unholey Semiconductors, Science 283, 804 805 1999.
- A.L. Pope, T.M. Tritt, M.A. Chernikov, M. Feuerbacher, Thermal and Electrical Transport Properties of the Single-Phase Quasicrystalline Material: *Al*_{70.8}*Pd*_{20.9}*Mn*_{8.3} Appl. Phys. Lett. 75, 1854 – 1856 (1999).
- 13. M.A. Karami, M. Sc. Thesis (Material and Energy Research Center, Iran, 2006).
- 14. H.P. Klug, L. Alexander, X-ray Diffraction Procedures for Polycrystalline and Amorphous Materials (John Wiley& Sons, New York, USA, 1974).
- 15. M. Herrmann, H. Fietzek, Investigation of the Micro Structure of Energetic Crystals by Means of *X*-Ray Powder Diffraction, Advances in *X*-ray Analysis 48, 52 – 58 (2005).
- 16. David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics 88th ed (2007).
- 17. A.V. Petrov, V.A. Kutasov, Thermoelectric Properties of Semiconductors (New York, 1964).
- 18. G.M. Kavei, A. Karami, Fabrication and Characterization of the *p*-type $(Bi_2Te_3)_x(Sb_2Te_3)_{1-x}$ Thermoelectric Crystals Prepared via Zone Melting, Bull. Mater. Sci. 29 (7), 659 – 663 (2006).
- 19. G. Kavei, Y. Zare, A. Seyyedi, Tentative Designs for Measurements of Absolute Value of Thermal Conductivity of Semi-Conducting Thermoelectric Elements, J.Thermoelectricity 2, 57 61 (2008).
- 20. O. Kubaschewski, Materials Thermochemistry, 6-th ed. (Pergamon Press, Oxford, 1993).
- 21. J.W. Anthony, R.A. Bideaux., K.W. Bladh, M.C. Nichols, Handbook of Mineralogy (Mineral Data Publishing, Tucson, Arizona, USA, 1990).
- 22. H.J. Goldsmid, Porous Thermoelectric Materials, Materials 2, 903 910 (2009).
- 23. M. Kaviany, Principles of Heat Transfer in Porous Media (Springer, New York, 1991).
- 24. A.M. Druma, M.K. Alam, C. Druma, Surface Area and Conductivity of Open-Cell Carbon Foams, Journal of Minerals & Materials Characterization & Engineering 5(1), 73 86 (2006).

Надійшла до редакції 19.09.2011.